

專利讓售清單

No.	國別	專利名稱	專利證書號	產品分類
1	TW	晶圓級封裝	150344	WLP
2	TW	窗口 BGA 封裝結構	152682	BGA/LGA
3	TW	增進穩固及對位之晶片接合方法	177516	Flip chip
4	TW	具有增強金屬栓結構之電子裝置及其製造方法	176939	Bumping
5	TW	微間距內引腳之導線架製造方法及其形成之導線架	194269	Carrier
6	US	Integrated Circuit Packaging for Improving Effective Chip-Bonding Area	6960491	BGA/LGA
7	TW	中央焊墊記憶體堆疊封裝製程及結構	197628	BGA/LGA
8	TW	晶圓級晶片尺寸封裝結構及其製程(WAFER LEVEL CHIP SCALE PACKAGE)	198828	WLP
9	CN	散熱型球格陣列封裝構造	412076	BGA/LGA
10	TW	散熱型球格陣列封裝構造	I245387	BGA/LGA
11	CN	散熱型覆晶封裝構造	433192	Flip chip
12	CN	晶穴朝下晶片封裝構造及其製造方法	568012	BGA/LGA
13	CN	晶穴朝下晶片封裝構造及其製造方法	825217	BGA/LGA
14	TW	晶穴朝下晶片封裝構造及其製造方法	I260754	BGA/LGA
15	CN	芯片封裝體與堆疊型晶片封裝結構	441923	Stacked
16	TW	晶片封裝體與堆疊型晶片封裝結構	I258212	Stacked
17	CN	晶穴朝下型晶片封裝構造的製造方法及構造	425599	BGA/LGA
18	TW	晶穴朝下型晶片封裝構造之製造方法及構造	I264784	BGA/LGA
19	CN	引腳在晶片上之積體電路封裝構造及其晶片承載件	458450	TSOP
20	TW	引腳在晶片上之積體電路封裝構造	I285407	TSOP
21	CN	晶圓的激光標示方法	406079	Wafer level
22	TW	晶圓之雷射標示方法	I310582	Wafer level
23	CN	用於封裝之柔性基板	475098	COF
24	TW	用於封裝之可撓性基板	I253158	COF
25	US	CHIP PACKAGE HAVING ASYMMETRIC MOLDING AND TURBULENT PLATE DOWNSET DESIGN	7576416	TSOP
26	US	CHIP PACKAGE HAVING ASYMMETRIC MOLDING	7834432	TSOP
27	CN	不對稱鑄模之晶片封裝體	446442	TSOP
28	TW	不對稱鑄模之晶片封裝體	I273636	TSOP
29	US	CHIP PACKAGE WITH ASYMMETRIC MOLDING	7504714	TSOP
30	US	CHIP PACKAGE WITH ASYMMETRIC MOLDING	7964940	TSOP

No.	國別	專利名稱	專利證書號	產品分類
31	CN	不對稱鑄模之晶片封裝體	429962	TSOP
32	TW	不對稱鑄模之晶片封裝體	I283488	TSOP
33	CN	泛用型晶片封裝結構	430049	BGA/LGA
34	TW	泛用型晶片封裝結構	I284990	BGA/LGA
35	TW	防止銅層侵蝕之電路板及其鍍錫製程	I250830	Carrier
36	TW	多晶片模組封裝構造	I248179	Stacked
37	TW	記憶體封裝構造	I256115	BGA/LGA
38	TW	利用多層凸塊接合之驅動晶片封裝構造	I256120	COF
39	TW	薄型積體電路封裝構造	I256116	BGA/LGA
40	CN	改善壓模時晶片位移之半導體封裝構造	499122	TSOP
41	TW	改善壓模時晶片位移之半導體封裝構造	I261366	TSOP
42	CN	內引腳接合捲帶及使用該捲帶之捲帶承載封裝構造	490584	COF
43	TW	內引腳接合捲帶及使用該捲帶之捲帶承載封裝構造	I292936	COF
44	CN	防止黏晶膠污染晶片錳墊之封裝構造及其基板	472153	BGA/LGA
45	TW	防止黏晶膠污染晶片錳墊之封裝構造及其基板	I291751	BGA/LGA
46	CN	具有微細間距凸塊之半導體芯片和其凸塊	529848	Bumping
47	TW	具微細間距凸塊之半導體晶粒及其凸塊	I329917	Bumping
48	CN	晶片-晶片封裝體及其制程	784983	Wafer level
49	TW	晶片封裝體與用以製造具有膠層的晶片的晶圓處理方法	I288959	Wafer level
50	CN	減少軟板形變之薄膜覆晶封裝構造	490599	COF
51	TW	減少軟板變形之薄膜覆晶封裝構造	I309457	COF
52	CN	具陣列接墊的晶片封裝構造及其製造方法	568454	QFN
53	TW	具陣列接墊之晶片封裝構造及其製造方法	I308383	QFN
54	CN	高頻集成電路封裝構造及其製造方法	508032	BGA/LGA
55	CN	高頻集成電路封裝構造的製造方法	663917	BGA/LGA
56	TW	高頻積體電路封裝構造	I295092	BGA/LGA
57	US	晶片封裝結構及其製造方法	7514299	BGA/LGA
58	CN	晶片封裝結構及其製造方法	472166	BGA/LGA
59	US	晶片封裝結構及其製造方法	7446400	TSOP
60	CN	晶片封裝結構及其製造方法	486348	TSOP

No.	國別	專利名稱	專利證書號	產品分類
61	TW	晶片封裝結構及其製造方法	I301316	TSOP
62	TW	晶片尺寸封裝結構之製造方法及其結構	I271834	WLP
63	TW	柱格陣列封裝構造	I278079	BGA/LGA
64	TW	可防止引腳斷裂之可撓性基板	I285523	COF
65	CN	一致化凸塊接合高度的高頻集成電路封裝構造及製造方法	548346	Flip chip
66	TW	一致化凸塊接合高度之高頻積體電路封裝構造及其製造方法	I313924	Flip chip
67	CN	可插接的捲帶式封裝構造以及使用該構造的電子裝置	746753	COF
68	CN	沖裁式無外引腳封裝構造及其製造方法	534108	QFN
69	TW	沖裁式無外引腳封裝構造之製造方法	I309541	QFN
70	US	FILM TYPE PACKAGE FOR FINGERPRINT SENSOR	7936032	FPS
71	CN	指紋辨識器的薄膜封裝構造	523820	FPS
72	TW	指紋辨識器之薄膜封裝構造	I320545	FPS
73	CN	薄膜倒裝封裝的電路捲帶及其薄膜倒裝封裝構造	652116	COF
74	CN	增進散熱效益的半導體封裝載膜與封裝構造	644722	COF
75	TW	增進散熱效益之半導體封裝載膜與封裝構造	I362093	COF
76	US	Semiconductor Packaging Substrate Improving Capability of Electrostatic Dissipation	7732911	COF
77	US	Semiconductor Packaging Substrate Improving Capability of Electrostatic Dissipation	8253235	COF
78	CN	增強靜電消散能力的半導體封裝基板	508358	COF
79	TW	增強靜電消散能力的半導體封裝基板	I337402	COF
80	CN	指紋辨識器的薄膜封裝構造	556779	FPS
81	CN	晶片接合時靜電放電防護的捲帶式半導體封裝構造	508345	COF
82	CN	防止薄膜塌陷形成填膠氣泡的薄膜覆晶封裝構造	548330	COF
83	TW	防止薄膜塌陷形成填膠氣泡之薄膜覆晶封裝構造	I315572	COF
84	CN	增加引腳強度的半導體封裝載膜與封裝構造	523819	COF
85	CN	晶片與承載器的接合方法	570634	Flip chip
86	US	晶片封裝體	7479706	Carrier
87	CN	芯片封裝結構	534120	Carrier
88	TW	晶片封裝體	I330884	Carrier
89	US	IC PACKAGE REDUCING WIRING LAYERS ON SUBSTRATE AND ITS CHIP CARRIER	7781898	Carrier
90	US	IC PACKAGE REDUCING WIRING LAYERS ON SUBSTRATE AND ITS CARRIER	8026615	Carrier

No.	國別	專利名稱	專利證書號	產品分類
91	CN	減少基板線路層的晶片封裝構造及其晶片載體	603127	Carrier
92	TW	減少基板線路層之晶片封裝構造及其晶片載體	I341576	Carrier
93	CN	芯片上具有圖案的四方扁平無引腳封裝方法	678505	QFN
94	TW	晶片上具有圖案的四方扁平無引腳封裝結構	I352409	QFN
95	CN	多芯片堆疊的封裝結構及其封裝方法	660041	Stacked
96	TW	多晶片堆疊的封裝結構	I339887	Stacked
97	CN	芯片堆疊封裝結構及其製造方法	676954	Stacked
98	TW	晶片堆疊封裝結構及其應用	I345295	Stacked
99	US	Chip-stacked Package Structure And Method For Manufacturing The Same	7884486	Stacked
100	CN	芯片堆疊封裝結構及其製造方法	568914	Stacked
101	US	Chip-Stacked Package Structure	7696629	Stacked
102	CN	晶片堆疊封裝結構	609130	Stacked
103	TW	晶片堆疊封裝結構及其應用	I447869	Stacked
104	CN	用於無引腳封裝的引線框及其封裝結構	634295	QFN
105	TW	用於無引腳封裝之導線架及其封裝結構	I341565	QFN
106	CN	具有金屬間隔物的多芯片堆疊結構	723509	Stacked
107	CN	多晶片堆疊的封裝結構	600228	Stacked
108	TW	多晶片堆疊的封裝結構	I335055	Stacked
109	CN	捲帶式半導體封裝構造及其基板	590364	COF
110	TW	捲帶式半導體封裝構造及其基板	I345292	COF
111	CN	用於一半導體封裝結構的基板、半導體封裝結構及其製造方法	746909	Carrier
112	TW	用於一半導體封裝結構之基板、半導體封裝結構及其製造方法	I375308	Carrier
113	CN	增進散熱效益的捲帶式半導體封裝構造	583428	COF
114	CN	用於一封裝裝置的接合結構	673458	BGA/LGA
115	CN	晶片封裝結構、晶片承載帶及其平坦化方法	583536	COF
116	TW	晶片封裝結構、晶片承載帶及其平坦化方法	I354361	COF
117	CN	多芯片堆疊的封裝結構	677085	TSOP
118	TW	多晶片堆疊之封裝結構	I378547	TSOP
119	US	Method for Fabricating Multi-Chip Stacked Package	7919358	TSOP
120	CN	多芯片堆疊封裝方法	602685	TSOP

No.	國別	專利名稱	專利證書號	產品分類
121	TW	多晶片堆疊之封裝方法	I364802	TSOP
122	TW	具張力檢視設計之可撓性基板	I301733	COF
123	CN	覆晶封裝製程	704929	Flip chip
124	CN	芯片封裝單元	760064	Stacked
125	CN	芯片封裝單元	1137986	Stacked
126	TW	晶片封裝單元	I490998	Stacked
127	US	Chip Package Structure	7939950	Stacked
128	CN	晶片封裝結構	771018	Stacked
129	TW	晶片封裝結構	I358816	Stacked
130	CN	芯片封裝構造及其支撐裝置	746367	COF
131	TW	晶片封裝構造及其支撐裝置	I362091	COF
132	CN	芯片封裝捲帶及包含該芯片封裝捲帶的芯片封裝結構	742469	COF
133	TW	晶片封裝捲帶及包含該晶片封裝捲帶之晶片封裝結構	I364822	COF
134	US	METHOD OF FABRICATING QUAD FLAT NON-LEADED PACKAGE	7842550	QFN
135	CN	四方扁平無引腳封裝的製造方法	1108567	QFN
136	TW	四方扁平無引腳封裝的製造方法	I378515	QFN
137	CN	平坦化金屬凸塊表面的方法	750565	Bumping
138	CN	芯片封裝結構製程	914788	Flip chip
139	TW	晶片封裝	I393197	Flip chip
140	CN	芯片封裝結構製程	912762	Flip chip
141	TW	晶片封裝結構製程	I393192	Flip chip
142	US	CHIP PACKAGE	7638880	Stacked
143	CN	芯片封裝	799653	Stacked
144	TW	晶片封裝	I367556	Stacked
145	TW	具有散熱功能虛置圖案之半導體封裝基板	I317547	COF
146	CN	晶片封裝構造以及封裝方法	824412	COF
147	TW	晶片封裝構造以及封裝方法	I429033	COF
148	CN	封裝基板以及芯片封裝構造	844037	COF
149	TW	封裝基板以及晶片封裝構造	I378541	COF
150	US	QUAD FLAT NON-LEADED CHIP PACKAGE	7851896	QFN

No.	國別	專利名稱	專利證書號	產品分類
151	CN	四方扁平無引腳封裝	850031	QFN
152	TW	四方扁平無引腳封裝	I462252	QFN
153	US	Manufacturing Process For A Quad Flat Non-Leaded Chip Package Structure	7803666	QFN
154	CN	四方扁平無引腳封裝製程	890734	QFN
155	TW	四方扁平無引腳封裝製程	I371813	QFN
156	CN	封裝基板以及晶片封裝結構	948319	COF
157	TW	封裝基板以及晶片封裝結構	I393232	COF
158	CN	封裝基板以及芯片封裝結構	844409	COF
159	TW	封裝基板以及晶片封裝結構	I393234	COF
160	US	多晶片堆疊封裝	8237249	Stacked
161	CN	多芯片堆疊封裝	913176	Stacked
162	TW	多晶片堆疊封裝	I401785	Stacked
163	CN	凹穴芯片封裝結構及使用其的層疊封裝結構	950378	Stacked
164	TW	凹穴晶片封裝結構及使用凹穴晶片封裝結構之層疊封裝結構	I442522	Stacked
165	CN	晶圓切割方法	1246691	Wafer Level
166	TW	晶圓切割方法	I401737	Wafer Level
167	TW	具錯位式引腳彎折之半導體封裝載膜與封裝構造	I332697	COF
168	US	Chip Package With A Dam Structure On A Die Pad	7812432	QFN
169	TW	晶片封裝體	I364820	QFN
170	US	Chip Package and Manufacturing Method Thereof	7843054	TSOP
171	TW	晶片封裝結構及其製造方法	I364827	TSOP
172	US	MANUFACTURING PROCESS FOR A CHIP PACKAGE STRUCTURE	7851270	BGA/LGA
173	TW	晶片封裝結構的製程	I393193	BGA/LGA
174	US	Manufacturing Process for A Quad Flat Non-leaded Chip Package Structure	7795079	QFN
175	US	MANUFACTURING PROCESS FOR A QUAD FLAT NON-LEADED CHIP PACKAGE STRUCTURE	7803667	QFN
176	TW	四方扁平無引腳封裝製程	I375287	QFN
177	US	METHOD FOR MANUFACTURING PACKAGING STRUCTURE	8093106	Flip chip
178	US	PACKAGING STRUCTURE	8736060	Flip chip
179	CN	封裝結構及其製造方法	1355946	Flip chip
180	TW	封裝結構及其製造方法	I428996	Flip chip

No.	國別	專利名稱	專利證書號	產品分類
181	US	Method for Manufacturing A Semiconductor Structure	8058109	Flip chip
182	CN	制造半导体结构的方法	1161821	Flip chip
183	TW	製造一半導體結構之方法	I416641	Flip chip
184	TW	探測卡之探針形成方法	173254	Probe card
185	TW	立體彈性微探針之微機電製造方法	190865	Probe card
186	TW	具有彈性突出電極之軟性電路板及其製造方法	181850	Others
187	TW	晶片尺寸封裝之影像感測器	I226680	CIS
188	TW	薄膜覆晶型態影像感測封裝結構及其製造方法	I239602	CIS
189	TW	金屬密封之影像感測器	I227942	CIS
190	TW	多基板影像感測器結構及其製造方法	I239095	CIS
191	TW	密封感測區之影像感測器	I239106	CIS
192	TW	微型顯示器模組之製造方法及其結構	I245960	LCOS
193	TW	具有鉀線橋之微型顯示器模組	I227363	LCOS
194	TW	晶圓級玻璃覆晶影像感測器之製造方法及其結構	I241018	CIS
195	TW	玻璃覆晶封裝型態影像感測器之製造方法及其結構	I242819	CIS
196	TW	覆晶型態影像感測晶片	I245417	CIS
197	TW	四方扁平無接腳影像感測器封裝及其製造方法	I234870	CIS
198	TW	影像感測器之捲帶封裝方法及構造	I244203	CIS
199	TW	軟板對位窗之影像感測器封裝構造	I232567	CIS
200	TW	發光二極體之封裝方法及其構造	I235511	LED
201	US	影像感測器之封裝方法及其結構	7420267	CIS
202	CN	影像感測器之封裝方法及其結構	458456	CIS
203	TW	影像感測器之封裝方法及其結構	I244177	CIS
204	TW	低雜訊多晶片影像感測器構造	I236768	CIS
205	TW	減少應力之微型顯示器模組	I252953	LCOS
206	TW	軟性帶狀材之切割裝置	I258451	Tool
207	CN	影像感測晶片與玻璃基板的結合構造及其製造方法	582440	CIS
208	TW	影像感測晶片與玻璃基板之結合構造及方法	I290350	CIS
209	CN	封裝載體的檢測方法及其裝置	477576	Testing
210	TW	封裝載體之檢測方法及其裝置	I297190	Testing

No.	國別	專利名稱	專利證書號	產品分類
211	CN	影像感測器之玻璃覆晶封裝構造	490600	CIS
212	TW	影像感測器之玻璃覆晶封裝構造	I312581	CIS
213	CN	光源組件	520900	LED
214	TW	光源模組	I314792	LED
215	US	LIGHT EMITTING CHIP PACKAGE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7510889	LED
216	CN	發光晶片封裝體及其製造方法	594585	LED
217	TW	發光晶片封裝體及其製造方法	I313943	LED
218	US	LIGHT EMITTING CHIP PACKAGE AND LIGHT SOURCE MODULE	7459783	LED
219	CN	發光芯片封裝體與光源組件	624079	LED
220	TW	發光晶片封裝體與光源模組	I320608	LED
221	TW	量測電鍍層活性厚度之校正方法	I278053	Testing
222	TW	影像感測晶片之氣閉密封構造	I280648	CIS
223	TW	晶片承載盤之檢測方法	I271506	Testing
224	TW	影像感測器之玻璃覆晶封裝構造	I273686	CIS
225	US	晶片封裝體及其製造方法	7642137	LED
226	US	CHIP PACKAGE	7932531	LED
227	CN	晶片封裝體及其製造方法	779226	LED
228	TW	晶片封裝體及其製造方法	I325644	LED
229	CN	光源組件及用於此光源組件的調整亮度的方法	669396	LED
230	TW	光源模組及用於此光源模組的調整亮度的方法	I341599	LED
231	CN	光源組件	711322	LED
232	TW	光源模組	I348773	LED
233	TW	發光二極體封裝結構	I306652	LED
234	TW	防止固化時揮發性氣體污染影像感測區之玻璃覆晶感測器封裝構造及其製造方法	I307148	CIS